LAGENAUFBAU HDI (Standard)

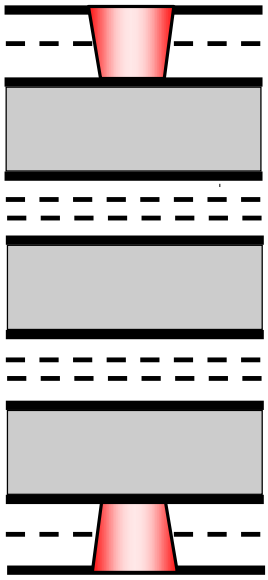
HDI08_1+6+1_1,10_17.5

8 - Lagen

Kerne: 0,20 mm Cu 17/17 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 6 + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	66	
	2			17,5 µm		16	
			0,200 mm			200	
	3			17,5 µm		16	
					2 x 1080	134	
	4			17,5 µm		16	
			0,200 mm			200	
	5			17,5 µm		16	
					2 x 1080	134	
	6			17,5 µm		16	
			0,200 mm			200	
	7			17,5 µm		16	
					1 x 1080	66	
	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	
			1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm				
					Gesamtdicke Material:	1120	
					Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)		

MATERIALDICKE:	**1,10**	+/-	0,07	mm			Datum: / Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,18	+/-	0,10	mm			
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,24	+/-	0,12	mm			
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:		

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
25.04.2006	**S. Keller**		M.Kress	25.04.2006	R. Schönholz	00	7+